



华为昇腾950超节点真机亮相WAIC，曙光8000全国产十万卡AI超集群真机首秀

AI算力行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年07月21日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

华为昇腾950超节点真机亮相WAIC，业界最大规模算力底座登场

7月17日，2026世界人工智能大会在上海开幕，华为首次以真机形式展出昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）。该产品基于自研灵衢互联协议和超节点架构，实现业界最大的1024卡规模，提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4澎湃算力，具备256TB全局统一内存编址空间、TB级NPU互联带宽和3μs超低时延三大核心优势，专为万亿级大模型训练与高并发推理场景设计。同时亮相的还有Atlas 850E风冷超节点，依托自研VCE相变散热技术，无需液冷改造即可在标准机柜部署，单节点可扩展至96卡，支持10ms级时延推理和M级超长上下文，大幅降低企业部署门槛。软件生态方面，昇腾CANN等基础软件已全面开源，社区上线67个项目、累计开源代码超1244万行、月活跃开发者突破3500人。商用落地层面，上一代昇腾384超节点已在全球部署750多套，覆盖互联网、金融、医疗等20多个行业，是国内唯一训练出SOTA模型的超节点；昇腾已携手3000多家合作伙伴孵化7000多套行业解决方案，服务2000多家政企核心客户。

曙光8000全国产十万卡AI超集群真机首秀

7月17日，2026世界人工智能大会在上海开幕，中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）真机首次面向全球公开亮相，并入选本届大会“镇馆之宝”。曙光8000采用超智融合技术路线，实现科学计算与智能计算原生融合，支持FP64至INT8全精度计算，可覆盖科学计算、大模型训练与推理、工业仿真等多类场景，并贯通芯片、计算、存储、网络、散热、应用和服务全链路。在系统工程层面，其采用全球首创的高密度机柜结构，单个计算单元算力密度较其他超节点提升20倍，同时搭载自研scaleFabric原生IBDMA高速互连技术，实现十万卡规模的超高速稳定互连。目前，曙光8000已依托国家超算互联网接入全国一体化算力网，完成300余项重点应用优化，覆盖大模型、机器人、创新药、新材料、量子计算、天文气象等20余个领域，超70项应用实现万卡规模扩展，并持续支撑蛋白质折叠模拟、万亿原子级水分子动力学模拟等科学智能应用。作为首个落地运行的全国产十万卡AI超集群，曙光8000折射出AI基础设施竞争正由单点技术迈向系统能力的新阶段。

建议关注：天数智芯、惠科股份、兴森科技、航天电器。

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-07-17 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
9903.HK	天数智芯	495.20	-3.98	-1.78	0.89	-124.42	-278.20	556.40	买入
001399.SZ	惠科股份	23.51	0.58	0.63	1.31	40.53	37.32	17.95	买入
002436.SZ	兴森科技	34.06	0.08	0.26	0.44	425.75	131.00	77.41	买入
002025.SZ	航天电器	64.76	0.77	1.10	2.15	84.10	58.87	30.12	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

目录

CONTENTS

1. 算力板块周度行情分析
2. 行业动态
3. 公司公告

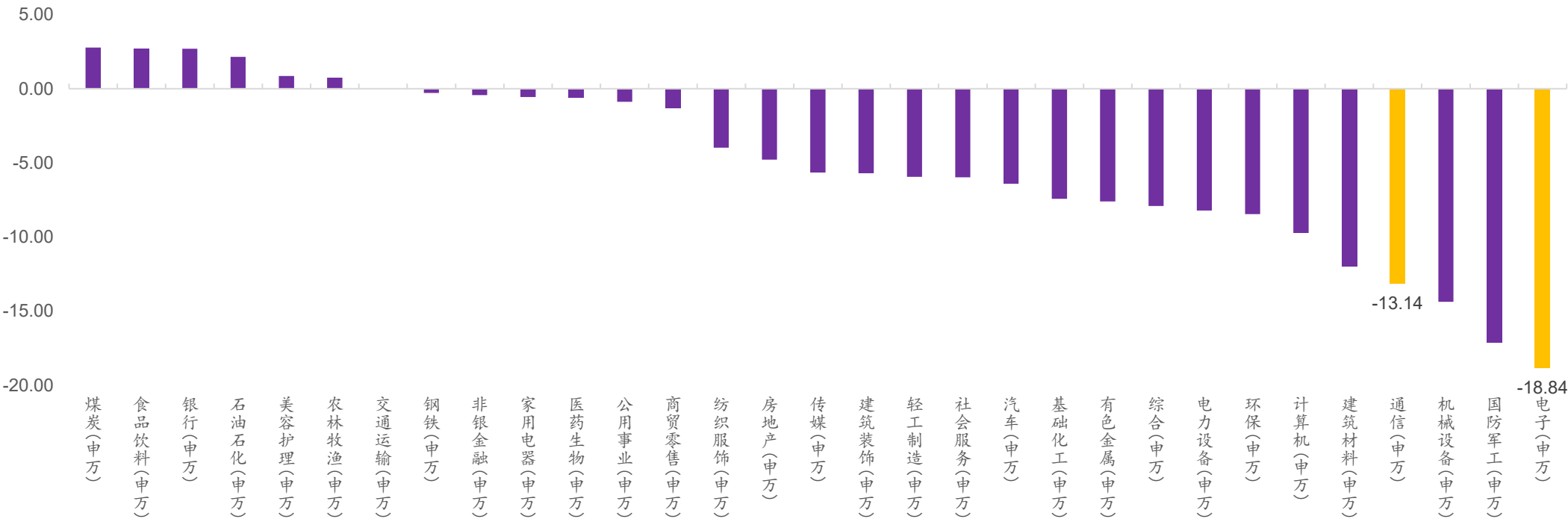
01 算力板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、申万一级行业周涨跌幅

跨行业比较，7月13日-7月17日当周，申万一级行业整体呈下跌的态势。其中通信行业下跌13.14%，位列第28位；电子行业下降18.84%，位列第31位。

图表2：7月13日-7月17日申万一级行业周涨跌幅比较（%）

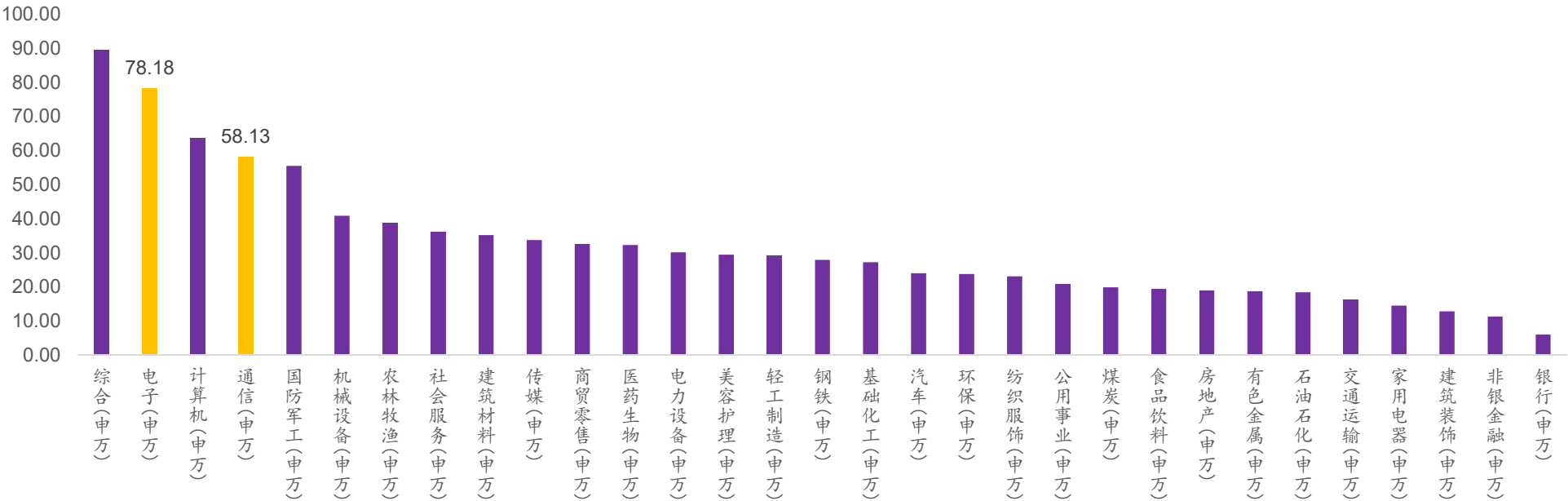


资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

跨行业比较，7月13日-7月17日当周，估值前三的行业为综合，电子和计算机行业，其中电子、通信行业的市盈率分别为78.18，58.13。

图表3：7月13日-7月17日申万一级行业市盈率比较

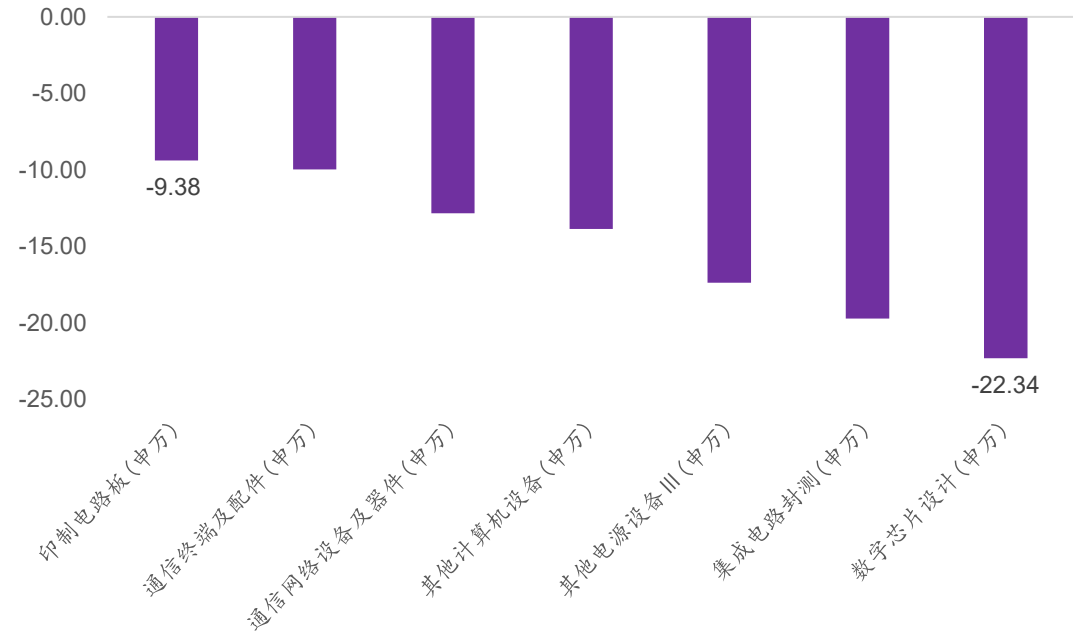


资料来源：wind，华鑫证券研究

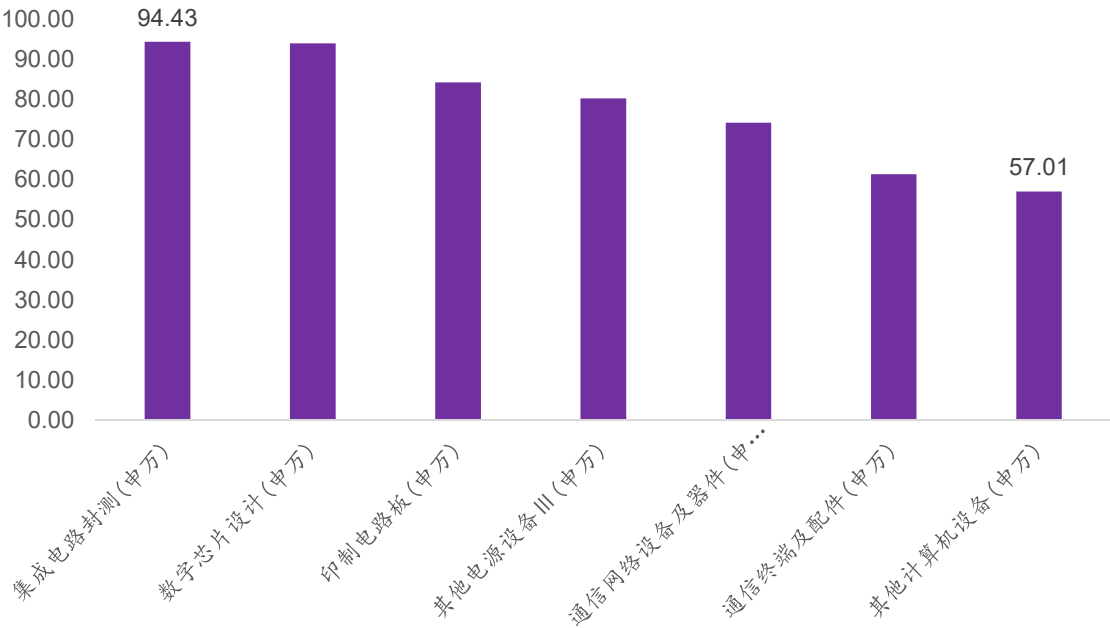
1.3、AI算力细分板块周度行情梳理

AI算力相关细分板块比较，7月13日-7月17日当周，AI算力相关细分板块全部呈下降态势。其中，数字芯片设计板块跌幅最大，达到22.34%。印制电路板板块跌幅最小，达到9.38%。估值方面，集成电路封测、数字芯片设计和印制电路板板块估值水平位列前三。

图表4：7月13日-7月17日AI算力相关细分板块周涨跌幅比较（%）



图表5：7月13日-7月17日AI算力相关细分板块市盈率比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万一级行业板块资金流向

上周申万一级行业资金流向情况：

上周通信板块主力净流出287.59亿元，主力净流入率为-2.73%，在31个申万一级行业中排第26名；电子板块主力净流出1350.10亿元，主力净流入率为-3.13%，在31个申万一级行业中排29。

图表6：7月13日-7月17日申万一级行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW美容护理	451,299.22	429,988.34	21,310.87	0.97	-1
SW商贸零售	2,024,401.59	2,000,416.26	23,985.33	0.27	-1
SW石油石化	2,842,488.95	2,815,877.29	26,611.66	0.25	-3
SW医药生物	27,557,828.52	27,596,259.53	-38,426.04	-0.04	-2
SW纺织服饰	1,255,600.56	1,268,825.06	-13,224.50	-0.24	-1
SW房地产	2,597,350.32	2,647,149.49	-49,799.17	-0.55	-1
SW农林牧渔	2,469,159.72	2,525,814.95	-56,655.23	-0.63	-1
SW钢铁	1,008,343.39	1,040,687.68	-32,344.28	-0.80	-3
SW综合	667,859.43	689,291.95	-21,432.52	-0.85	-5
SW轻工制造	1,687,937.71	1,757,222.97	-69,285.25	-0.86	-2
SW建筑装饰	3,635,558.85	3,770,862.55	-135,303.70	-0.90	-5
SW汽车	8,950,794.56	9,258,624.46	-307,829.90	-0.94	-1
SW食品饮料	4,696,843.09	4,902,389.23	-205,546.14	-1.21	-2
SW煤炭	1,138,012.56	1,210,073.25	-72,060.69	-1.23	-3
SW公用事业	6,305,080.95	6,639,670.55	-334,589.60	-1.36	-5
SW环保	2,057,976.03	2,180,694.79	-122,718.75	-1.42	-2
SW基础化工	14,682,602.72	15,553,009.17	-870,406.44	-1.51	-3
SW有色金属	18,424,383.20	19,369,237.31	-944,854.11	-1.52	-3
SW社会服务	1,069,996.75	1,159,749.44	-89,752.69	-1.82	-2
SW传媒	8,045,369.53	8,520,811.19	-475,441.66	-1.85	-1
SW建筑材料	5,112,739.19	5,435,658.18	-322,919.00	-1.94	-3
SW电力设备	26,690,744.12	28,390,328.54	-1,699,584.42	-1.97	-3
SW计算机	24,919,088.05	26,515,095.52	-1,596,007.47	-2.12	-1
SW交通运输	2,447,424.31	2,711,362.56	-263,938.25	-2.25	-5
SW非银金融	9,112,198.01	9,760,324.61	-648,126.60	-2.31	-2
SW通信	50,181,377.49	53,057,250.31	-2,875,872.83	-2.73	-3
SW家用电器	3,338,339.84	3,673,675.09	-335,335.25	-2.83	-3
SW机械设备	28,080,649.17	30,819,745.16	-2,739,097.33	-2.97	-5
SW电子	176,732,783.01	190,233,716.67	-13,500,933.65	-3.13	-3
SW国防军工	11,000,627.79	12,617,152.71	-1,616,524.91	-4.23	-5
SW银行	4,941,399.50	5,709,503.50	-768,104.00	-4.63	-5

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、AI算力细分板块资金流向

AI算力相关板块资金流向情况：
上周印制电路板板块主力净流出39.73 亿元，主力净流入率为-0.68%，在8个子行业 中排第1名；集成电路封测板块主力净流出115.81亿元，主力流入率为-3.15%，在8个子行业中排第8名。

图表7：7月13日-7月17日AI算力相关行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW印制电路板	26,901,920.60	27,299,292.85	-397,372.25	-0.68	-1.00
SW通信终端及配件	2,266,439.05	2,330,897.90	-64,458.85	-0.85	-1.00
SW其他电源设备III	3,159,699.98	3,254,408.61	-94,708.63	-1.11	-3.00
SW集成电路制造	7,207,347.80	7,434,355.56	-227,007.75	-1.35	-5.00
SW通信网络设备及器件	38,893,487.00	40,990,946.05	-2,097,459.05	-3.06	-3.00
SW其他计算机设备	7,107,629.13	7,712,722.10	-605,092.97	-3.06	-5.00
SW数字芯片设计	45,378,313.83	48,374,931.36	-2,996,617.53	-3.13	-5.00
SW集成电路封测	14,722,318.18	15,880,375.78	-1,158,057.59	-3.15	-5.00

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

随着 5G 通信、人工智能、大数据中心、汽车电动化和智能化等新兴技术的快速发展对 PCB 的需求在数量和质量上都提出了更高要求。例如，5G 基站建设需要大量高频、高速 PCB 板以实现信号的高速传输；汽车智能化使得汽车电子系统日益复杂，对车用 PCB 的可靠性和性能要求大幅提升。

过去几十年，PCB 产业经历了从欧美向日本、台湾地区，再向中国大陆的转移过程。目前，中国大陆已成为全球最大的 PCB 生产基地，拥有完整的产业链和成本优势。未来，随着新兴市场的崛起，产业可能进一步向具有成本和技术优势的地区转移，同时供应链也将更加多元化和区域化。

PCB 行业呈现出一定的集中化趋势，头部企业在技术研发、资金实力、客户资源等方面具有明显优势，能够更好地应对市场变化和竞争挑战。头部企业通过不断扩大产能、提升技术水平和拓展市场份额，进一步巩固了其市场地位。

中低端PCB市场，由于进入门槛相对较低，竞争较为激烈，企业主要通过价格战来争夺市场份额。而在高端市场，如高多层板、高频高速板、封装基板等领域，技术壁垒较高，企业需要不断投入研发，提升产品质量和性能，以差异化竞争获取市场份额。

中国台湾拥有完善的PCB产业链，从上游的覆铜板、铜箔、玻纤布等原材料生产，到中游的PCB制造，再到下游的电子组装和应用，包括终端客户的认证等各方面都具备很强的优势和竞争力。完善的产业链配套体系使得台湾 PCB产业在全球范围内都具有很强的竞争力。因此，中国台湾PCB产业链上下游公司的营收具备一定的代表性，反映行业的发展趋势和景气度。

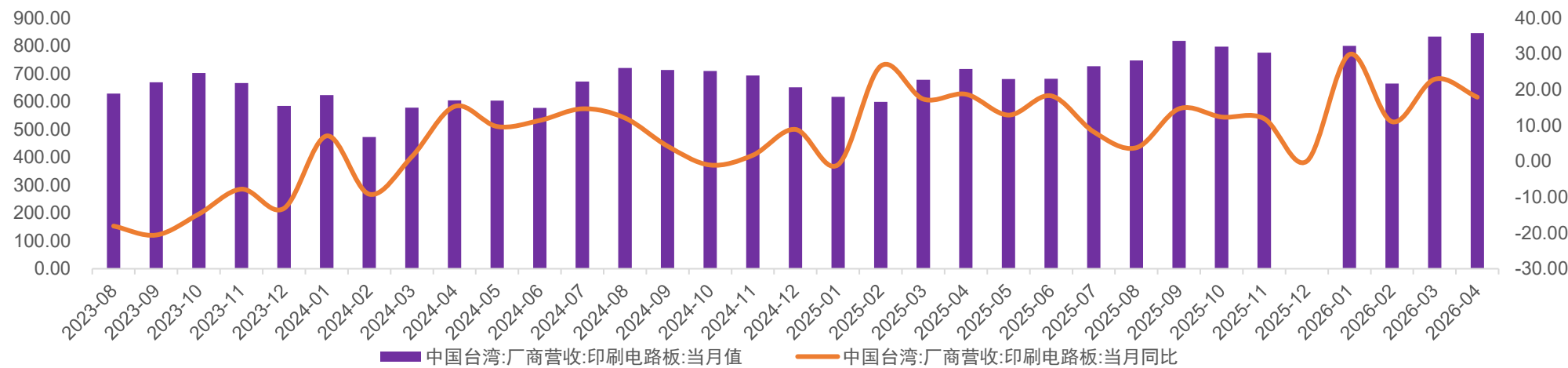
中游PCB厂商：从长期的维度来看，2023-2025年PCB行业经历了从衰退到复苏的阶段。2023年全年大部分月份营收同比增长率为负，行业处于衰退状态。但从2024年开始，同比增长率逐渐转正，行业进入复苏阶段，并在2025年行业整体实现了较为稳定的增长。这表明 PCB行业经历了一段下行时期之后，逐渐走出低谷，迎来了新的发展机遇。

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

从中期的维度来看，对比2024年和2025年的数据可以发现，行业从2024年初开始逐步复苏。2024 年 1 月台湾PCB厂商营收为 622.53 亿新台币，同比增长7.05%。2025年，台湾PCB厂商营收规模进一步扩大，增长率也保持在较高水平。尽管行业整体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。在2024年和2025年中，同比增长率都有较大幅度的波动，2024年2 月增长率为- 9.21%，之后又逐渐回升；2025年1月为- 0.99%，而2025年2月增长率为26.53%。波动的增长率反映出潜在的市场需求变化、季节性变化以及原材料价格波动等因素的影响。

从短期来看，下游AI算力需求旺盛带动AI-PCB需求提升。2025年各月营收当月值整体处于较高水平，除2024年2月为472.82亿新台币外，其余月份均在500亿新台币以上，且有个别月份超过 800 亿新台币。2025年11月，中国台湾PCB厂商营收达到774.72亿新台币，同比增长11.86%。2026年开年营收当月值处于较高水平，达到799.67亿新台币，**同比增长29.77%**，目前营收总体呈现上行的态势。

图表8：2023-2026年中国台湾印制电路板厂商营收及同比增速(亿新台币)



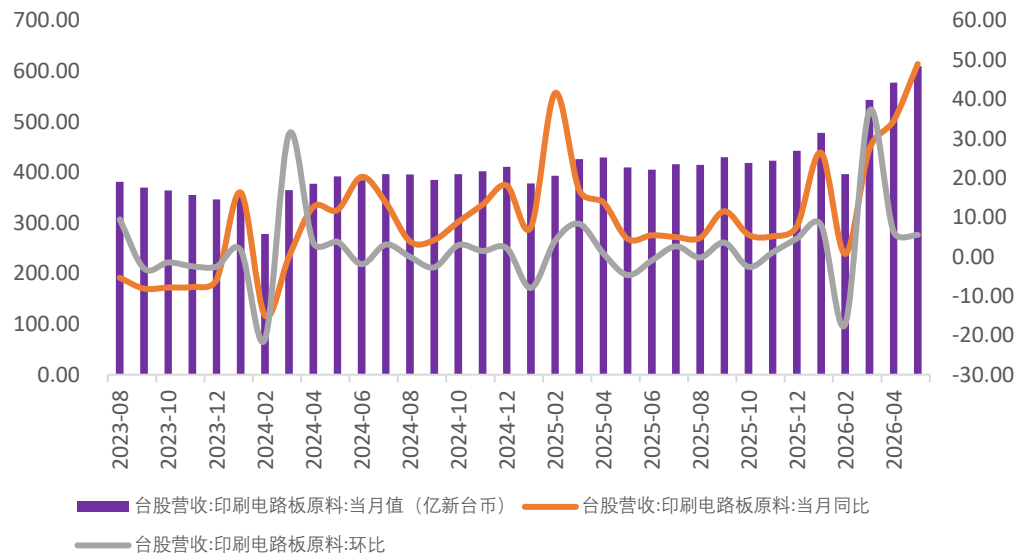
资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

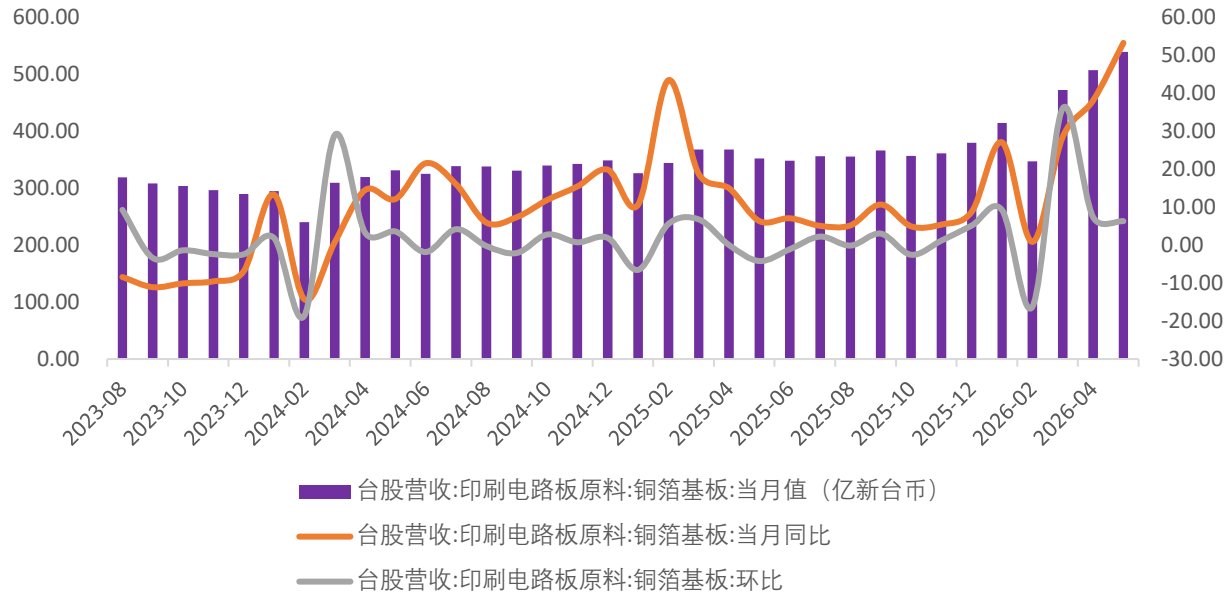
上游PCB基材厂商：5G、人工智能、汽车电子等新兴产业的发展对PCB上游基材提出新的要求，市场对于高频高速覆铜板和铜箔等材料的需求升级，M8-M9高频高速覆铜板和低表面粗糙度电子铜箔成为高端AI服务器的刚需。通常来说，PCB 上游基材的市场需求存在一定的季节性变化，第一季度通常是需求淡季，第四季度可能是需求旺季。

从最新的数据来看，2026年5月，中国台湾PCB原料厂商实现营收609.37亿新台币，同比增长48.95%，环比上涨5.53%；中国台湾铜箔基板厂商实现营收538.85亿新台币，同比增长53.23%，环比上涨6.29%。

图表9：2023-2026年台湾印制电路板原料厂商营收及增速（亿新台币）



图表10：2023-2026年台湾铜箔基板厂商营收及增速（亿新台币）

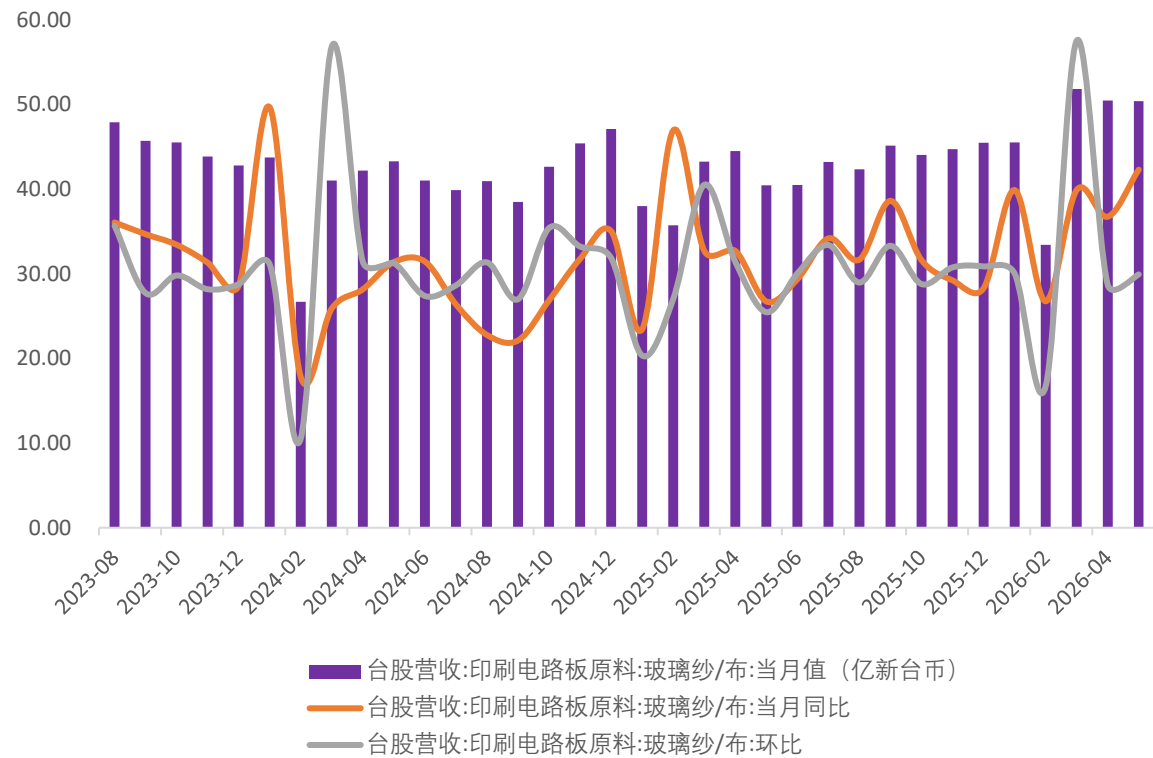


资料来源：wind，华鑫证券研究

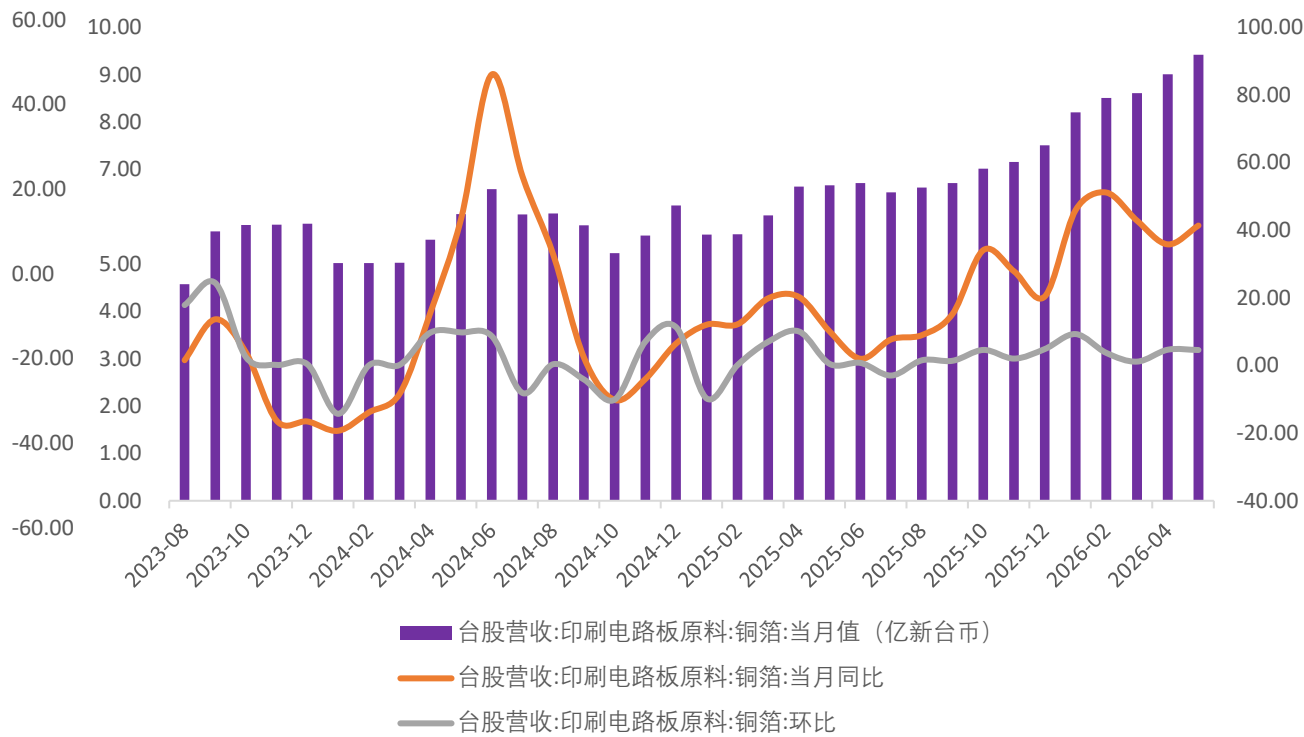
1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

中国台湾电子布厂商实现营收50.41亿新台币，同比上升24.62%，环比下跌0.15%；中国台湾电子铜箔厂商实现营收9.42亿新台币，同比增长41.38%；环比增长4.57%。

图表11：2023-2026年台湾电子布厂商营收及增速（亿新台币）



图表12：2023-2026年台湾电子铜箔厂商营收及增速（亿新台币）



资料来源：wind，华鑫证券研究

02 行业动态

研究创造价值

三星完成2nm特斯拉AI5流片，后续将在美国泰勒厂量产

当地时间2026年7月13日，三星晶圆代工首席工程师James Kim在Linkedin上发布消息，确认特斯拉AI5芯片已完成流片，将采用三星2nm级工艺在美国德克萨斯州泰勒工厂生产，并即将集成到特斯拉的最新产品中。这一进展距离台积电版本完成流片仅相隔数月。

James Kim在领英上写道：“三星代工的特斯拉AI5芯片已达成流片。计划采用我们最新的2nm工艺在美国泰勒工厂生产，并将很快集成到特斯拉的最新产品中。过去几个月能与帕罗奥图和奥斯汀的特斯拉杰出工程师们合作，深感荣幸。”今年4月，特斯拉CEO埃隆·马斯克就曾透露，AI5芯片设计已分别提交给三星和台积电进行代工，并展示了AI5芯片的样品。由于两家晶圆厂将芯片设计转化为实体电路的方式不同，各自生产的AI5版本存在细微差异。台积电版本早于三星数月完成流片，此次三星版本的完成流片意味着AI5芯片在两大代工厂的适配工作已全部落地。并且值得注意的是，业内此前普遍认为三星的2nm工艺将用于特斯拉后续的AI6芯片，而AI5则会采用台积电更成熟的制程。此次AI5直接采用三星2nm工艺，侧面印证了三星2nm良率已突破60%的关键门槛。近期报道显示，人工智能公司Anthropic也可能通过三星代工生产自研AI芯片。

AI5芯片是特斯拉HW4（AI4）的迭代产品，在多个维度实现了跨越式提升。马斯克曾表示，AI5的综合性能相比前代提升高达40倍，AI算力达到约2500 TOPS，是AI4的8倍之多。内存方面，AI5配备了144GB的内存容量，是AI4约16GB的9倍；内存带宽达到约1.9TB/s，是AI4的5倍。

Intel 18A良率升至85%，已获多家大厂订单

7月15日消息，根据外资投行KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh发布的最新研究报告显示，英特尔最先进的Intel 18A制程良率已突破85%，晶圆代工业务也获得了苹果、AMD、英伟达等头部客户的订单。EMIB-T先进封装良率高达98%，且将获谷歌、亚马逊导入。基于代工与封装业务的巨大增长潜力，KeyBanc首次给出英特尔2030年1320亿美元的营收预期，并将目标股价大幅上调至155美元。

Intel 18A良率升至85%。作为英特尔当前最先进的制程工艺，Intel 18A在去年底已经量产，首款基于该制程产品是代号为“Panther Lake”的酷睿Ultra 3系列处理器。虽然，Intel 18A量产初期的良率并不高，但是经过了半年多时间的持续优化，良率也在持续提升。

KeyBanc在最新的报告中指出，英特尔当前最关键的Intel 18A制程良率已从65%稳健提升至85%。虽然这一数字仍落后台积电N2（2nm）制程的90%的良率，但已明显超越三星晶圆代工（Samsung Foundry）SF2（2nm）制程的50%~60%的良率表现。此外，市场研究机构BlueFin Research Partners最新发布的分析报告还指出，升级版的Intel 18A-P节点目前已在俄勒冈州D1X厂进入风险试产阶段。该制程工艺能为设计人员带来极大的弹性优势，不仅能在相同功耗下提升9%的性能，也能在维持同等性能的情况下降低18%的功耗。就长期规划而言，Intel 18A-P节点的大规模量产未来将转移至Fab 62厂执行。

对于下一代的Intel 14A制程工艺，KeyBanc表示，相关开发仍按计划推进，在缺陷密度方面的进展优于同期的Intel 18A，并有望于2028年下半年如期进入量产。

台积电宣布对美投资增至2650亿美元，再建4座晶圆厂

7月16日，晶圆代工大厂台积电召开了2026年二季度法人说明会。Q2业绩超预期，净利同比大涨77.4%创历史新高，2nm制程也已开始贡献营收。台积电还宣布上调全年营收和资本支出，并回应了与三星和英特尔的竞争、先进封装、涨价等议题。更令人瞩目的是，台积电正式宣布对美国追加1000亿美元投资，使其在美国的总投资额将达2650亿美元。

Q2净利同比大涨77.4%。合并营收约新台币12,703.8亿元，同比增长36%，环比增长12%；毛利率67.7%，高于预期的65.5%至67.5%；营业利益率60.3%，同样优于预期的56.5%至58.5%；税后净利润约新台币7,065.6亿元，同比大涨77.4%，环比增长23.4%，创下历史新高；每股收益约新台币27.25元（折合美国存托凭证每单位为4.31美元），同比大涨77.4%。

对美国追加1000亿美元投资，再建4座晶圆厂。早在2020年台积电就宣布了在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂计划，并于2021年4月开始在该地区建造首个晶圆制造厂。随后，台积电宣布将对美投资扩大至650亿美元，除了最初的晶圆一厂之外，还将建立两座晶圆厂。2025年3月，台积电又宣布对美国追加1000亿美元投资，包含再建设三座新晶圆厂、两座先进封装设施，以及一个主要研发中心。这使得台积电对美国的总投资达到了1650亿美元。目前，台积电亚利桑那州第一座4nm晶圆厂已经开始量产；第二座3nm晶圆厂，目前正在建设当中，预计于2027年量产。这两座晶圆厂达产后，合计将年产超过60万片晶圆；第三座晶圆厂已经开始破土动工，将生产2nm或更先进的制程技术，预计将在2029~2030年间量产。

沪电股份2026上半年营收利润双增，国内外产能扩张布局加速

2026年07月16日，沪电股份发布投资者活动记录表公告。公司近日披露的2026年半年度业绩预告显示，受益于高速交换机、AI服务器等领域需求及产品结构优化，上半年营收和净利润同比均较快增长。泰国子公司从产能爬坡迈入规模化运营，二季度单季扭亏，二季度汇兑损失较一季度减少。

在经营策略上，数据通讯市场，AI重构PCB行业格局，公司深化差异化战略，聚焦高阶硬件所需高附加值核心PCB产品。智能汽车市场，汽车电子架构升级提升对汽车PCB需求，公司深化合作，优化产品和产能结构。

泰国工厂方面，2025年营收约2.89亿元，2026年一季度约2.95亿元，二季度单月产值超1.5亿元。数据通讯事业部超70%海外客户完成认证，产能利用率基本满载，产品量产且品质达国内水准，已实施产能升级扩容。汽车事业部进入量产阶段，产能爬坡，向数据通讯领域延伸。

产能布局上，国内兼顾短期效益与长期发展，聚焦高阶PCB瓶颈及关键制程，实施产能扩充，6月收购普江仓储100%股权用于产能扩建。同时，公司强化供应链安全，提前介入高端材料验证，落实战略安全库存，推进多元化与本地化认证。

长电科技上半年净利预增63%至102% AI需求驱动产能利用率持续提升

7月15日，长电科技发布2026年半年度业绩预增公告。公告显示，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润实现同比大幅增长。

经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.70亿元到9.50亿元，与上年同期相比，将增加2.99亿元到4.79亿元，同比增长63.48%到101.70%。

预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.40亿元到9.10亿元，与上年同期相比，将增加3.02亿元到4.72亿元，同比增长68.95%到107.76%。

上年同期，公司利润总额为5.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.71亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.38亿元，每股收益为0.26元。

对于本期业绩预增的主要原因，公司在公告中表示，受益于人工智能相关基础设施领域需求快速增长，半导体行业保持结构性高增，景气度持续提升。公司坚持聚焦主营生产业务，积极把握机遇，加强市场拓展，客户订单持续增长，产能利用率不断提升，营业收入和净利润实现增长。同时，公司持续优化产品结构和业务组合，高附加值产品增加，盈利能力进一步增强。此外，公司持续深化降本增效工作，加强成本费用管控，部分对冲原材料价格上涨等成本因素影响，经营效率提升，对利润端形成正向支撑。

端侧AI元年业绩兑现，边缘算力放量，A股芯片公司半年报最高预增2倍

7月以来，A股2026年半年报业绩预告进入密集披露期。在云端AI芯片增速边际放缓的背景下，端侧算力赛道交出亮眼成绩单：瑞芯微、全志科技等端侧AI芯片厂商先后发布预增公告，净利润最高增幅超200%，直接印证了AI算力从云端向终端、边缘下沉的产业拐点已经到来。

IDC最新发布的《2026年Q1全球端侧AI芯片市场报告》显示，2026年第一季度全球云端AI芯片出货量同比增长仅12%，较2025年同期35%的增速明显放缓；而边缘AI芯片出货量同比大增，其中面向IoT、工业边缘、智能终端的中低端AI芯片出货量涨幅更是突破110%，两者形成显著的增速剪刀差。

另据行业机构测算，中国市场方面，2026年边缘AI芯片市场规模将突破210亿元，同比增长38%，全年端侧AI整体市场规模有望达到8661亿元。这些数据显示，AI计算范式正在逐渐从集中式训练与推理向分布式推理的重大转移。

过去两年AI产业的重心集中在云端大模型训练，而随着3B-7B参数轻量化大模型技术成熟，端侧设备本地运行AI成为可能。相比云端推理，端侧AI具备低延迟、数据隐私性强、不依赖网络、部署成本低等核心优势，正在快速渗透到各个场景：2026年国内AI PC渗透率预计达到62%，AI手机渗透率达45%，成为端侧算力的基本盘；AI眼镜全年出货量预计同比增长107%至275万台，成为消费电子新的增长极；工业边缘、智能汽车座舱、服务机器人、智能安防等B端场景的AI改造需求更是呈现爆发式增长，智能终端的AI算力部署密度同比提升71%。

03 公 司 公 告

研究创造价值

■ 芯原股份:关于新签订单的自愿性披露公告

根据芯原微电子（上海）股份有限公司关于新签订单的自愿性披露公告。

2026年1月1日至2026年4月29日，芯原微电子（上海）股份有限公司新签订单82.40亿元，具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《2026年第一季度报告》。延续前期新签订单的强劲增长态势，公司2026年4月30日至2026年7月16日新签订单进一步增长，达到64.13亿元。

2026年1月1日至2026年7月16日，公司新签订单合计146.53亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，相关订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，芯片设计业务订单通常需9-12个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需6 -18个月生产周期（即包含产能锁定与排产等待在内的完整生产交付周期），期间逐步实现收入转化。

前述64.13亿元新签订单中，AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。

紫光股份:2026年半年度业绩预告

一、根据紫光股份有限公司2026年半年度业绩预告。

1. 业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30

2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形，具体如下：单位：人民币万元

归属于上市公司股东的净利润：盈利：191,000-232,000，比上年同期增长：83.50%-122.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：盈利：161,000-202,000，比上年同期增长：44.02%-80.69%

基本每股收益（元/股）：盈利：0.67-0.81

二、主要原因如下：

1、在人工智能算力需求爆发的强劲驱动下，2026年上半年ICT市场继续保持快速增长。公司积极把握智算和国产化领域带来的市场机遇，持续深耕行业市场；加快产品研发和技术创新；强化供应链精细化管理和运作以保障供给的稳定与交付的连续，从而推动公司营业收入实现快速增长，带动了毛利水平的持续提升。

2、公司原对于控股子公司新华三集团有限公司剩余19%的少数股东权益存在潜在收购义务，该义务作为金融负债计量，并在2025年12月之前对其计提利息费用。报告期内，该金融负债因到期不再对其计提利息费用。

3、2026年5月末公司完成新华三6.98%的股权收购，公司对新华三的持股比例从81%提升至87.98%，进一步增厚了归属于上市公司股东的净利润。

4、经初步测算，预计报告期内非经常性收益的金额约2.5亿-3.5亿元，主要是由于在新华三剩余19%股权交易过程中产生的非经常性收益增加。截至2026年5月末，新华三剩余19%股权交易已完成，该非经常性收益在未来没有可持续性。上年同期的非经常性损失是0.77亿。

■ 中科曙光:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

(一) 本次发行的基本条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币800,000.00万元。

(二) 转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格为108.89元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(三) 本次募集资金用途：单位：万元

- ① 面向人工智能的先进算力集群系统项目，项目投资总额：350,000.00，拟投入募集资金金额：350,000.00
- ② 下一代高性能AI训推一体机项目，项目投资总额：250,000.00，拟投入募集资金金额：250,000.00
- ③ 国产化先进存储系统项目，项目投资总额：200,000.00，拟投入募集资金金额：200,000.00

海光信息:关于2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

根据海光信息技术股份有限公司关于2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告。

(一) 业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日

(二) 业绩预告情况：

1. 经财务部门初步测算，预计2026年上半年实现营业收入850,000.00万元到930,000.00万元，与上年同期相比，将增加303,576.49万元到383,576.49万元，同比增长55.56%到70.20%。
2. 预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润170,000.00万元到183,000.00万元，与上年同期相比，将增加49,854.82万元到62,854.82万元，同比增长41.50%到52.32%。扣除股份支付的影响后，预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润217,000.00万元到230,000.00万元，与上年同期相比，将增加92,478.07万元到105,478.07万元，同比增长74.27%到84.71%。
3. 预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润151,000.00万元到170,000.00万元，与上年同期相比，将增加41,998.65万元到60,998.65万元，同比增长38.53%到55.96%。扣除股份支付的影响后，预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润198,000.00万元到217,000.00万元，与上年同期相比，将增加84,621.91万元到103,621.91万元，同比增长74.64%到91.40%。

(三) 本期业绩变化的主要原因：公司持续优化“CPU+DCU”业务布局，通过高强度研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，保持了国内领先的市场地位。报告期内，在人工智能大模型加速迭代、AI Agent应用规模化落地、国产化进程迈向商业化应用的多重驱动下，公司持续加码研发投入、迭代优化产品性能，牢牢把握发展机遇期，推动公司高端处理器产品的市场版图扩展，实现了公司营业收入的快速增长，整体业绩的持续增长。

通富微电:2026年半年度业绩预告

根据通富微电子股份有限公司2026年半年度业绩预告。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形，具体如下：单位：万元

归属于上市公司股东的净利润：160,000 ~ 180,000，比上年同期增长：288.26% ~ 336.80%

扣除非经常性损益后的净利润：70,000 ~ 80,000，比上年同期增长：66.49% ~ 90.28%

基本每股收益（元/股）：4.0519

二、业绩变动原因说明

2026年上半年，在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。

此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司2026年上半年业绩。

04 风 险 提 示

研究创造价值

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研创造价值